

EPBOARD 0700

Epoksydowa płyta narzędziowa

ZASTOSOWANIA

EPBOARD 0700 to epoksydowa płyta narzędziowa o wysokiej odporności cieplnej, szczególnie odpowiednia do wykonywania modeli form do prepregów epoksydowych w procesie autoklawowym, oprzyrządowania do kompozytów utwardzanych cieplnie oraz form do formowania próżniowego. Może być też bezpośrednio używana na formy do krótkich serii części kompozytowych.

CECHY

- Wysoka stabilność wymiarowa • Wysoka odporność na pękanie
- Łatwa obróbka • Dobra stabilność krawędzi
- Wysoka odporność cieplna • Mały współczynnik rozszerzalności cieplnej
- Mała gęstość • Dobra jakość powierzchni

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Produkt	EPBOARD 0700
Kolor	Niebieski
Gęstość	0,70-0.75g/cm3

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Właściwość	Norma badania	EPBOARD 0700
Twardość	ISO868:2003	Shore D 72
Temperatura ugięcia pod obciążeniem	DIN EN ISO 75B	130°C
Wytrzymałość na zginanie	ENISO178	36MPa
Moduł sprężystości przy zginaniu	ENISO178	2100MPa
Wytrzymałość na ściskanie	ENISO604	50MPa
Wytrzymałość na rozciąganie	ENISO527-1	23MPa
Moduł sprężystości przy rozciąganiu	ENISO527	2400MPa
Udarność	ENISO179	5.3KJ/m2
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej	ENISO113590-2	39*10-6K-1

Temperatura (°C)	23	80	100	130	150
Twardość Shore D	72	70	68	66	55

ZALECENIA OBRÓBKİ:

Klejenie płyt:

1. Przytnij, przygotuj i złóż bloki na sucho.
2. Przeszlifuj obie powierzchnie złącza papierem o gradacji 320.
3. Usuń pył sprężonym powietrzem, następnie oczyść powierzchnie klejenia odpowiednim rozpuszczalnikiem, np. acetonem.
4. Przed klejeniem pozwól odparować resztkom rozpuszczalnika.
5. Rozprowadź równomiernie około 600 g kleju epoksydowego na obu powierzchniach złącza za pomocą pacy zębatej.
6. Połącz obie powierzchnie z mokrym klejem i wywieraj równomierny nacisk, aż klej zacznie wypływać ze złącza. Usuń nadmiar i sprawdź, czy spoina ma równomierną grubość nieprzekraczającą 1 mm.
7. Przytrzymaj płyty lekkim dociskiem lub rozłożonym na całej górnej powierzchni stosu obciążeniem, aby zapewnić równomierny nacisk.
8. Przed dalszą obróbką zawsze zapewnij klejowi wystarczający czas utwardzania.
9. Aby uzyskać maksymalne właściwości cieplne systemu, zaleca się dotwardzanie. Część powinna stygnąć w autoklawie do temperatury pokojowej z szybkością nie większą niż 20 °C na godzinę. Zapobiega to szokowi cieplnemu płyty i kleju, który mógłby osłabić połączenie i wywołać pęknięcia naprężeniowe płyty.

Podparcie:

Płyta musi być odpowiednio podparta, aby uniknąć nadmiernych naprężeń od ciężaru własnego. Dla dużych modeli zaleca się stalową ramę wsporczą, która ogranicza ugięcia i ułatwia przenoszenie. Do mocowania konstrukcji wsporczej lub ramy do płyty używaj jednego z zalecanych klejów. Przy mechanicznym mocowaniu płyt wysokotemperaturowych zachowaj ostrożność: różnice współczynników rozszerzalności cieplnej mogą powodować wypaczenie lub mikropęknięcia podczas nagrzewania i chłodzenia.

DOSTĘPNE WYMIARY PŁYT

1500*500*50mm

1500*500*75mm

1500*500*100mm

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Pracuj w dobrze wentylowanym miejscu. Podczas obróbki unikaj kontaktu ze skórą i stosuj rękawice, maskę, okulary oraz odzież ochronną. Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki materiału.

08-2024 EPBOARD 0700 Strona 2/3

UWAGA:

Powyższe dane uzyskano w określonych warunkach badań. Procedury i warunki rzeczywistego zastosowania mogą się różnić, dlatego przed użyciem zaleca się w razie potrzeby przeprowadzenie prób i potwierdzenie spełnienia rzeczywistych wymagań. EPTEK gwarantuje zgodność swoich produktów z własnymi najwyższymi zasadami zarządzania jakością.

08-2024 EPBOARD 0700 Strona 3/3